
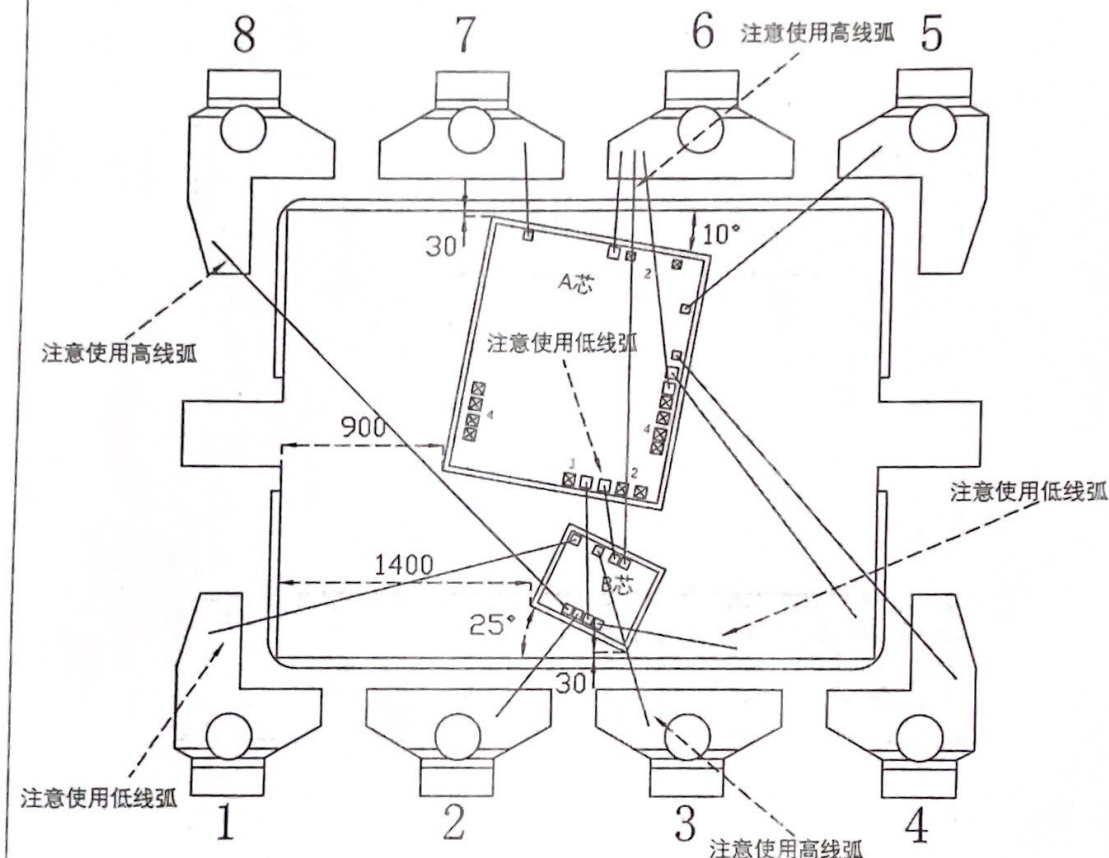


<div></div> <div>池州华宇电子科技股份有限公司</div> <div>CHI ZHOU HISEMI ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD</div> <div>焊线图纸 Bonding Diagram</div>				客户代码 Customer No.	008	版本号 Drawing No.	HY-PX-008-744 A	
				产品名称 Product Type	HS24G1820		封装外型 PKG Type	ESOP8L (12R)
焊线种类 Wire Type	焊线直径(μm) Wire Diameter	焊线根数 NO. of wire	焊线总长(μm) Total wire length	最长线长(μm) Longest wire length	最短线长(μm) Shortest wire length	塑料型号(绿色环保) Compound Type (Green)		LF载体尺寸 LF Pad Size
合金丝 Ag	20	14	20864	2851	470	非选(Preferrad): EM15-G630AY 备选(Optional): CEL-17021 (F)		ESOP8L-12R (95 × 130mil) 2527 × 3404μm ²

客户图号
Customer drawing NO.



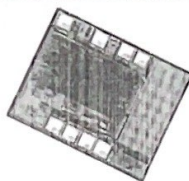
板板特选方向(板片):
L/P Direction (D/A):

椭圆孔



引脚图:
Chip photo:

B 芯实物图



特殊说明 Special Instructions:

DB 注意:
1. 以施工单要求按顺序贴片, 如: 先装A芯片, 装B芯片时必须要有A芯片的框架, 反之先装B芯片, 装A芯片时B芯片已装片;
2. 注意贴片精度, 控制溢胶, 为WB预留焊线位置。
WB 注意:
1. 数字为不打线pad点个数;
2. 植球点在A端

说明 Remarks	贴片胶类型 Epoxy type	芯片名称 Die name	芯片尺寸 Die Size	最小焊盘尺寸 Min SMD (μm ²)	最小焊盘间距 Min BPP (μm)	焊盘厚度(μm) Pad Thickness	焊盘下是否有电路 Circuit under Pad	贴片线宽度 Street line (μm)	晶圆尺寸 Wafer Size	是否足 Lot/Yes	减薄厚度 Trim (μm)
A 芯: DIE A	导电胶 (conductivity) S502	MG04-L02	1329.3*1176.3(μm ²) 52.33*46.21(mil ²)	63*63	84.3	2.8	是/Yes	62	12	是/Yes	300
B 芯: DIE B	导电胶 (conductivity) S502	HS5150	535.6*433.2(μm ²) 21.09*17.06(mil ²)	30.35*30.35	62	1	是/Yes	60	8	否/NO	300
C 芯: DIE C											

板制 Prepared by	李林 2024.4.15	制图日期 Create Date	2024/4/15	生效日期 Effective Date		客户确认签字/盖章: Customer Signature	
研发审核 R&D Check	李林 2024.4.15	产品工程审核 PE Check		批准 Approved by		杨瑞 2024.4.15	

温馨提示: 本图作为生产下线的唯一依据, 请仔细确认, 我司依据此图进行生产, 如因该图有误产生不可估量损失, 谢谢!
warm tips: the drawing is the only basis for the production of the product. Please confirm it carefully. Our company will produce the drawings according to the drawings you have signed back, such as drawing mistakes, which will produce inevitable loss. Thank you

页码 Page

1 / 1